

EDITORIAL

Visionen als Ausgangspunkt für Innovationen 201

VERBÄNDE



-Informationen 235

F E D - Informationen 257

ZVEI: -Informationen
Die Elektroindustrie 285

MAPS - Mitteilungen
DEUTSCHLAND 312

3-D MID - Informationen 339

DVS - Mitteilungen 369

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 204

Neue Normen 217

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 218

Embedded World 2014 – Rekorde zeichnen sich ab 223

BAUELEMENTE

LED für Projektoren 230

ARM-basierte Kommunikationsprozessoren 231

Kondensatoren mit niedrigem ESR
und verlängerter Lebensdauer 232

Wird der 2D-Zinn Stanen das nächste Supermaterial? 233

Wireless-Network-Prozessor für die Internet-Konnektivität 234

DESIGN

Multidesign – gleichzeitig verschiedene PCB-Designs
in 3D bearbeiten 237

Weiterer Ausbau der Software- und Informationsbasis
für Elektronikdesigner 241

EDM-System für Elektrokonstruktion 244

DESIGN

Fujitsu auf dem Weg zum Rechenzentrum der Zukunft 247

Thermoanalyse von elektronischen Baugruppen 256

Multisim 13.0 optimiert die Simulation
von Schaltungsdesigns 256

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit):
LED eine wachsende Chance für Leiterplattenhersteller 271

Lötfreie Steckverbindung setzt neue Maßstäbe
für die Kontaktierung auf der Leiterplatte 274

Laserschneiden im Fokus
des LPKF-PCB-Technologietags 2013 278

Bearbeiten von Leiterplatten aus PCB-Material
und Aluminium 280

MSC präsentiert neue Produktserie
für das Hochtemperaturlaminieren 282

Fehler über Fehler 283

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Standard-Reflow-Löten für thermisch
sensible Bauelemente 294

Auswahl von passenden Dosierkomponenten 300

FED-Konferenz – Qualifying in der Elektronikbranche 302

SN100C Sublizenzierung und Aufnahme in die ISO 9453 306

Referenzdesign-Kit für NFC-Anwendungen 307

Microtronic – Partner für Produkte, Training,
Support und Service 308

Infrarot-Kameramodul eröffnet vielseitige Möglichkeiten
für neuartige Projekte 311

ANALYTIK & TEST

Aktuelle Schaltmodule und Chassis 319

ViTrox Technologies' V810 XXL ausgezeichnet 322

Weltpremiere eines Flying Probers mit neuer Technologie 323

Schnelle optische 3D-Vermessung von Oberflächen
in der Halbleiterindustrie 328

Inspection Days 2013 – mehrere Neuheiten vorgestellt 330

VJ Electronix mit neuem X-Ray-Inspektionssystem X-Quik 333

Schnellere Marktreife von Produkten
durch EMV-Qualifizierung in der Entwicklungsphase 334

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Charakterisierung der Hochfrequenz-Eigenschaften von Materialien für LDS-MID	341
Miniaturisierte energieautarke Komponenten mit verlässlicher drahtloser Kommunikation für die Automatisierungstechnik (MIKOA)	346
Herstellungsprozesse und Produktionsausrüstung für ein flexibles organisch/anorganisches Mikrosystem auf der Basis innovativer Rolle-zu-Rolle Druck-, Dispensier- und Integrationstechnologien	350
Patente	364

FORUM

Microelectronics Saxony – Ausbau der Mikro- und Nanotechnologie an der TU Dresden	370
Neues Modell für das magnetische Verhalten von Schicht-Kobaltaten	380
Kolumne – Anders gesehen: Ein Löffelchen Rizinusöl	382
PLUS-Firmenverzeichnis	384
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	408
Mediadaten	410
Stellenmarkt	411
Inserentenindex	414
Impressum	415
Produkt des Monats	416

Titelbild: ITEQ Europe ist im Auftrag der ITEQ Corporation aus Taiwan, einem führenden Hersteller von CCL und PP, verantwortlich für den ganzen europäischen Markt. In Italien verfügt Iteq Europe über ein sehr gut ausgerüstetes und vollautomatisiertes Lager, in dem es Schnitt- und Lasermarkierungsdienstleistungen für CCL sowie Schrittdienstleistungen für PP anbietet.

www.iteqeuropa.eu

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e.V.
Tel. +49 (0) 8563 9788908
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org



Fachverband Elektronik-Design e.V.
Tel. +49/30/8349059
info@fed.de, www.fed.de



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e.V.
Tel. +49/3677/69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49/91 1/5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de



European Interconnect Technology Initiative e.V.
Tel. +49/69/6302-281
eiti@zvei.org, www.eiti.org



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49/211/1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.